



产品规格书/Specification

产品/product:	氮化硅陶瓷发热电阻浆料/ Si₃N₄ ceramic board heating Resist paste
料号/Part number:	05H71

适用范围/Application:

此产品适用于氮化硅陶瓷加热电路使用。

The resist paste applies to Si₃N₄ ceramic heating resistor paste.

与 01H-7103 电极银浆匹配使用

使用条件/Operating conditions:

基材 Substrate	氮化硅陶瓷 Si ₃ N ₄ ceramic
印刷 Printing	200-250 目丝网印刷 200-250 mesh stainless screen
流平 Levelling	室温下流平 5-15 分钟（时间根据流平的实际情况决定）。 5-15min minutes at room temperature
干燥 Drying	通风烘箱烘烤 100-150℃，10-15 分钟 （烘烤温度低于 300℃，可根据烘烤的实际情况决定烘烤时间。） 100-150℃ 10-15 min
烧结 Firing Condition	隧道炉空气氛下烧结，峰值 800℃（推荐值），10 分钟。 Atmospheric firing in belt furnace with peak time of 10 Minutes at 800℃
Thinner	ST1001

性能/Characteristics:

1. 浆料性能/Paste Characteristics:

性能 Characteristic	标准 Standard	测试方法及条件 Test method and conditions
1 Fineness	≤8μm	FOG test
2 Viscosity	120-280Pa.s	Brookfield HBT utility cup and spindle (SC4-14/6R), 10rpm, 25±1℃, Brookfield HBT (博利飞) 粘度计, 转子 SC4-14/6R), 10rpm, 25±1℃ 粘度可根据用户实际需要调节。

2. 烧结后特性/Characteristics after firing:



在 1 烧结条件下, 膜厚 8-12 μ m Check fired film produced under the conditions specified in 1), (Film thickness is 8-12 μ m.)

特性 Characteristics	Standard 标准	测试方法和条件 Test method and conditions
3 外观 Appearance	紧凑, 致密 Compact and unknit	Eyeballing
4 方阻值 Resistivity	如下表格 As below form	标准膜厚 10 μ m Standard film thickness is 10 μ m.
	温度系数 TCR	如下表格 As below form HTCR 25-125 $^{\circ}$ C

产品系列	氧化硅陶瓷发热电阻浆料 Si_3N_4 ceramic board heating Resist paste			
P/N	Resistivity (Ω/\square)	TCR (ppm/ $^{\circ}$ C)	烧结温度 $^{\circ}$ C Sintering	Viscosity (kcps)
05H71-0R02012	0.02	1200	850	120-280
05H71-0R03012	0.03	1200		
05H71-0R05012	0.05	1200		
05H71-0R10012	0.10	1200		
05H71-0R20012	0.20	1200		
05H71-0R30012	0.30	1200		
05H71-0R50012	0.50	1200		
05H71-1R00012	1.00	1200		
05H71-3R00012	3.00	1200		
05H71-4R00012	4.00	1200		
05H71-5R00012	5.00	1200		
05H71-011	10.00	1200		

Sintering

保存条件, 有效期/Storage condition and Term of validity

产品应在 5-25 $^{\circ}$ C 的环境温度下密封储存, 有效期为产品发货之日起六个月。

包装方式/Packaging method:

1000g/罐, 1000g/can